



DOVER 道尔

道尔化学·电子胶水专家
DOVER CHEMICAL ELECTRONIC ADHESIVES EXPERT

中国地区授权代理



深圳市力邦泰科技有限公司
南山区南山大道深意工业大厦516

Tel : 86-755-88864001
www.NewBonder.com

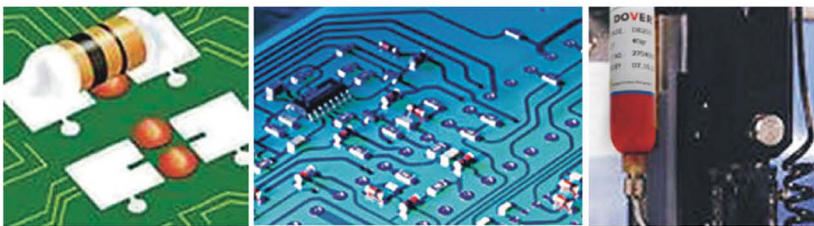


SMT表面贴装胶水



DOVER系列贴片胶是环氧树脂（快速热硬化作用）粘合剂，其中DE205具有高剪切稀释粘性特征，所以适用于高速表面贴片组装机（针筒式）点胶机用，特别适用于各种超高速点胶机（如:HDF）。DE206/DE208H的粘度特性和摇变性，特别适用于钢网/铜网印胶制程，并能获得良好成形而有效预防PCB板的溢胶现象。产品均按无公害产品的要求，设计开发成要求高温耐热性的无铅(Pb-Free)焊接上适用的产品。

DOVER series products are thermal cured epoxy adhesives. DE205 can be used in syring dot on the high speed chip mounter with its excellent control of dot shape.DE205 especially suit HDF SERIES.DE206/DE208H particularly suit for brass/steel screen because their viscosity and thixotropic.The products can well mold and effectually prevent excessive glue on the PCB.The products are all designed to the hightemperature Pb-free sealing technics according to the requirement of nuisanceless.



型号 Item	应用 Application	有/无铅工艺 Pb/Pb-free	颜色 Color	固化条件 Cure Condition	储存 Storage	包装方式 Package
DE205	点胶 针筒式 Syring	适用 Pb/Pb-free	红色 Red	150°C 60秒 150°C 60s	密封冷藏 6个月/5°C Sealed&refrigerated 6months/5°C	30/33/40gr
DE206	刮胶 Screen	适用 Pb/Pb-free	红色 Red	150°C 60秒 130°C 90秒 150°C 60s 130°C 90s	密封冷藏 6个月/5°C Sealed&refrigerated 6months/5°C	200gr/360gr
DE208H	刮胶 Screen	适用 Pb/Pb-free	红色 Red	150°C 60秒 130°C 90秒 150°C 60s 130°C 90s	密封冷藏 6个月/5°C Sealed&refrigerated 6months/5°C	200gr/360gr
DE215	点胶 针筒式 Syring	适用 Pb/Pb-free	红色 Red	150°C 60秒 150°C 60s	密封冷藏 6个月/5°C Sealed&refrigerated 6months/5°C	30/33/40gr
DE216	刮胶 Screen	适用 Pb/Pb-free	红色 Red	150°C 60秒 130°C 90秒 150°C 60s 130°C 90s	密封冷藏 6个月/5°C Sealed&refrigerated 6months/5°C	200gr/360gr
DE216A	刮胶 Screen	适用 Pb/Pb-free	红色 Red	150°C 60秒 130°C 90秒 150°C 60s 130°C 90s	密封冷藏 6个月/5°C Sealed&refrigerated 6months/5°C	200gr/360gr
DE225	点胶 针筒式 Syring	适用 Pb/Pb-free	红色 Red	150°C 60秒 150°C 60s	密封冷藏 6个月/5°C Sealed&refrigerated 6months/5°C	30/33/40gr
DE235	点胶 针筒式 Syring	适用 Pb/Pb-free	红色 Red	100°C 120秒 90°C 220秒 100°C 120s 90°C 220s	密封冷藏 6个月/5°C Sealed&refrigerated 6months/5°C	30/33/40gr

COB邦定胶水

COB encapsulants COB邦定黑胶

DOVER系列环氧包封剂单组份环氧树脂胶，是IC邦定之最佳配套产品。专供IC电子晶体的软封装用，适用于各类电子产品，例如计算器、PDA、LCD、仪表等。其特点是流动性适中，流量稳定，易于点胶成型。固化后具有阻燃、抗弯曲、低收缩、低吸潮性等特性，能为IC提供有效保护。此包封剂的设计是经过长时间的温度、湿度、通电等测试和热循环而研制成的优质产品。胶水均适应无铅工艺。

Dover series epoxy encapsulant single component epoxy resin adhesive is the best ic bonding matching product which is dedicated exclusively to soft package of ic electronic crystal and applicable to all types of electronic products, such as calculator, pda, lcd and instruments. Its moderate liquidity and stable flow make it easy dispensing and forming, which results in its properties of flame retardance, bending resistance, low shrinkage, low moisture absorption, etc. After curing it can provide effective protection for ic. The design of this encapsulant is one of high quality products developed after longterm tests on temperature, humidity electricity, heat circulation and so on. The glue applies to lead-free technology.

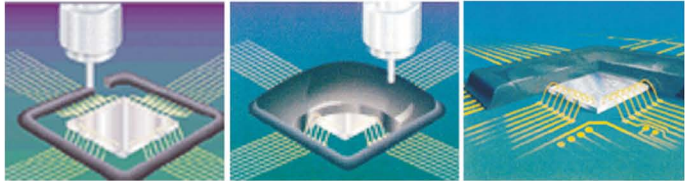


型号 Item	特性 Property	应用描述 Application description	颜色 Color	固化条件 Cure Condition	储存 Storage	包装 Package
DE101	低胶 Low glue	流动性好 胶点成型高度低 Good fluidity, low glue dots forming	黑 Black	150°C 45分钟 120°C 90分钟 150°C 45mins 120°C 90 mins	密封冷藏 6个月/5°C Sealed/refrigerated 5°C/6months	5kg/桶 5kg/Barrel
DE103	高胶 High gule	流动性一般 胶点成型高度高 Average fluidity, high glue dots forming	黑 Black	150°C 60分钟 120°C 90分钟 150°C 60 mins 120°C 90 mins	密封冷藏 6个月/5°C Sealed/refrigerated 5°C/6months	5kg/桶 5kg/Barrel
DE108	高温胶 High temperature glue	可耐回流焊/波峰焊 Enduring reflow/wave welding	黑 Black	150°C 45分钟 120°C 90分钟 150°C 45 mins 120°C 90 mins	密封冷藏 6个月/5°C Sealed/refrigerated 5°C/6months	5kg/桶 5kg/tin
DE109H	无卤亮光 HALOGEN-FREE & GLITTERY	可耐回流焊/波峰焊 Enduring reflow/wave welding	黑 Black	150°C 30分钟 130°C 40分钟 150°C 30 mins 130°C 40 mins	密封冷藏 6个月/5°C Sealed/refrigerated 5°C/6months	1.5kg/桶 1.5kg/tin
DE106	可返修 Repairable	常温开胶返修 Room temperature repair	黑 Black	150°C 60分钟 150°C 60 mins	密封冷藏 100天 Sealed/refrigerated 100D	5kg/桶 5kg/tin

围堰填充胶&四角邦定胶

DAM&FILL Adhesive 围堰填充胶

DOVER系列围堰填充胶系列单组分环氧胶，适用于环氧玻璃基板的IC封装之用途，如电池线路保护板等产品。该产品具有优异的耐焊性和耐湿性，低热膨胀系数以减少变形，优异的温度循环性能和较佳的流动性。



型号 Item	特性 Property	应用描述 Application Description	颜色 Color	固化条件 Cure Condition	储存 Storage	包装方式 Package
DE117D	围堰胶 DAM	能精确控制封装的高度 Exactly control the height of package	灰色 Gray	先100°C 60mins 后120°C 120mins 100°C@60mins+ 120°C@120mins	密封冷藏 180天/-5°C Sealed / Refrigerated -5°C/180D	70克/40克 70gr/40gr
DE117F	填充胶 FILL	极好流动性/固化后平面状 Excellent fluidity/ plane surface after curing	灰色 Gray	先100°C 60mins 后120°C 120mins 100°C@60mins+ 120°C@120mins	密封冷藏 180天/-5°C Sealed / Refrigerated -5°C/180D	70克/40克 70gr/40gr

Corner Bond 四角邦定胶

DOVER系列Corner Bond 是单组分环氧密封胶，用于CSP&BGA的四角辅助辅强制程工艺。它通过点胶工艺施胶于CSP&BGA的四角位置。固化后能有效地降低芯片与基板之间外力的冲击。良好的触变特性保证了其施胶后胶水的形状保持性。

DOVER series Corner Bond is the single component epoxy encapsulant which is used for strong auxiliary process technology of auxiliary of four corners of CSP&BGA. It spreads the bonder on four corners of CSP&BGA by way of dispensing technology and effectively lower the impact of external forces between chips and substrate after curing and its nicer thixotrophy guarantees its shape after the glue has been coated.



型号 Item	应用 Application	粘度 Viscosity	返修性 Repair	颜色 Color	固化条件 Cure Condition	储存 Storage	包装方式 Package
DE235	CSP/BGA	506Pa.s	可返修 Repairable	红色 Red	100°C 120秒 90°C 220秒 100°C 120s 90°C 220s	密封冷藏 6个月/5°C Sealed/refrigerated 5°C/6months	30/33/40gr
DE215	CPS/BGA	450Pa.s	可返修 Repairable	红色 Red	150°C 60秒 150°C 60s	密封冷藏 6个月/5°C Sealed/refrigerated 5°C/6months	30/33/40gr

底部填充胶&低温固化胶

Underfill Resin 底部填充胶

DOVER系列underfill是单组分环氧密封剂，用于CSP & BGA底部填充制程。它能形成一致和无缺陷的底部填充层，能有效地降低硅芯片与基板之间的总体温度膨胀特性不匹配或外力造成的冲击。较低的黏度特性使其更好的进行底部填充；较高的流动性加强了其返修的可操作性。



型号 Item	应用 Application	粘度 Viscosity	返修性 Repair	颜色 Color	固化条件 Cure Condition	储存 Storage	包装方式 Package
DU901	CSP/BGA	4000cps	可返修 Repairable	浅黄 Light yellow	150°C 5-10分钟 150°C 5-10mins	密封冷藏 6个月/5°C Sealed / Refrigerated 5°C/6months	250ml/30ml
DU902N	CSP/BGA	3000cps	可返修 Repairable	黑 Black	150°C 5分钟 120°C 20分钟 150°C 5 mins 120°C 20 mins	密封冷藏 6个月/5°C Sealed / Refrigerated 5°C/6months	250ml/30ml
DU902T	CSP/BGA	2000cps	可返修 Repairable	黑 Black	150°C 5分钟 120°C 20分钟 150°C 5 mins 120°C 20 mins	密封冷藏 6个月/5°C Sealed / Refrigerated 5°C/6months	250ml/30ml
DU986	CSP/BGA	430cps	可返修 Repairable	乳白 Milky white	150°C 3-5分钟 150°C 3-5 mins	密封冷藏 6个月/5°C Sealed / Refrigerated 5°C/6months	30ml/55ml

Low Temp Curable Adhesive 低温固化胶

DOVER系列低温固化胶是单组份、低温热固化改良型环氧树脂胶粘剂。该产品用于低温固化，并能在极短的时间内在各种材料之间形成最佳粘接力。产品工作性能优良，具有较高的保管稳定性，适用于记忆卡、CCD/CMOS等装置。特别适用于需要低温固化的热敏感元件。



型号 Item	黏度/pa.s Viscosity/pa.s	固化条件 Cure Condition	颜色 Color	粘接强度 Strength	储存 Storage	包装方式 Package
DE240	10-20	80°C@20分钟 120°C@5分钟 80°C@20mins 120°C@5mins	黑 Black	>2.5kg	密封冷藏 6个月/-20°C Sealed/refrigerated -20°C/6months	10ml/30ml
DE281H	14	80°C@5-10分钟 70°C@5-25分钟60°C@25-30分钟 80°C@5-10 mins 70°C@5-25 mins 60°C@ 25-30 mins	黑 Black	>2.5kg	密封冷藏 6个月/-40°C Sealed/refrigerated -40°C/6months	10ml/30ml
DE281W	11	80°C@5-10分钟 70°C@5-25分钟60°C@25-30分钟 80°C@5-10 mins 70°C@5-25 mins 60°C@ 25-30 mins	浅黄 Light yellow	>2.5kg	密封冷藏 6个月/-40°C Sealed/refrigerated -40°C/6months	10ml/30ml

深圳市力邦泰科技有限公司

关于力邦泰

深圳市力邦泰科技有限公司是一家专业的电子胶水方案提供商，提供专业的电子胶水应用技术顾问服务。力邦泰科技有限公司一直致力于不断超越、不断追求的创新与产品方案，以满足具有成本意识和品质意识的客户的高标准需要。我们的专业人员将为您提供高品质的产品，优质的服务和专业的技术咨询。我们不提倡纯粹的产品取代及以牺牲产品可靠性为前提的产品成本下降，我们更愿意配合客户建立更科学合理的产品综合性能评估方案。

经过七年的不懈努力，力邦泰科技已经为世界级的电子厂商及国内领先的电子厂商提供产品、服务及解决方案，并成为以下诸多公司之合格及优秀供应商。



.....

专业 · 专注 · 专心 Specialty · F engrossment · Concentration

力邦泰公司秉承对客户，对员工以及对环境负责之理念。为此我们承诺：

- 技术与销售相结合为客户提供迅速而贴心的服务；
- 对新产品和已销售的优质产品进行跟踪研究以确认产品质量的提高；
- 公平的员工待遇有助于更多的意见及建议的提出；
- 尽全力保障雇员、大众、环境之安全及公司财产和声誉。

深圳市力邦泰科技有限公司通过致力于产品的可靠性, 各项标准的遵守以及准确的物流来保证胶水的优质。在技术需求多样的今天，我们致力于使我们与众不同，成为一个在国内和国际领域可靠且负责任的公司。